

**ePaste** 汎用鉛フリーソルダペースト

# SN100C P504 D4



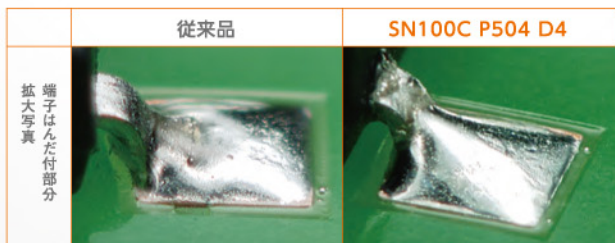
## ぬれ性を大幅改善!

錫銀銅系と同等の温度プロファイルで  
使用できるSN100C(Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge)ソルダペースト。  
ぬれ性を大幅に改善することで、端子のぬれ上がり、サイドボール、  
未熔融等ははんだ付時のトラブルを解決します。

無銀	鉛フリー	印刷用	汎用品
ぬれ上がり良好	サイドボール抑制	加熱だれ抑制	

### ぬれ上がり めっきの無いリード端子のぬれ上がりも良好

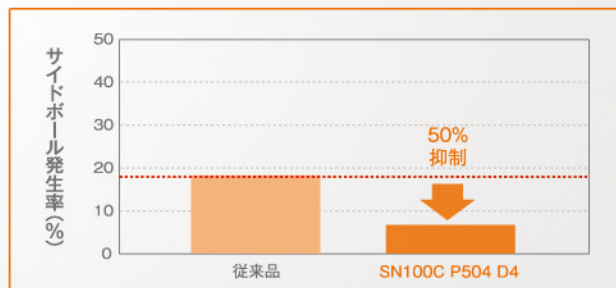
#### ■ 3端子のぬれ上がり比較



使用したリフロープロファイル  
・昇温速度: 1.5°C/sec. ・ピーク温度: 240°C ・はんだ熔融時間: 50sec.

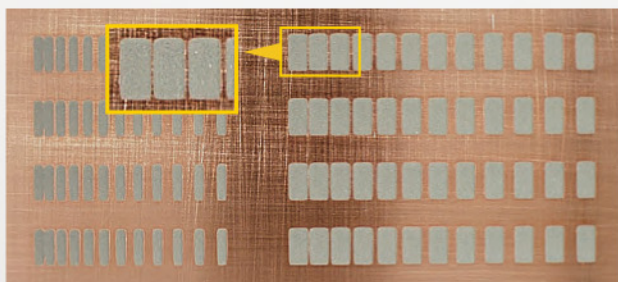
### サイドボール 実装後の検査機の異常発生を大幅減少

#### ■ サイドボール発生率



【試験条件】 昇温速度: 1.5°C/sec. ピーク温度: 240°C はんだ熔融時間: 50sec.

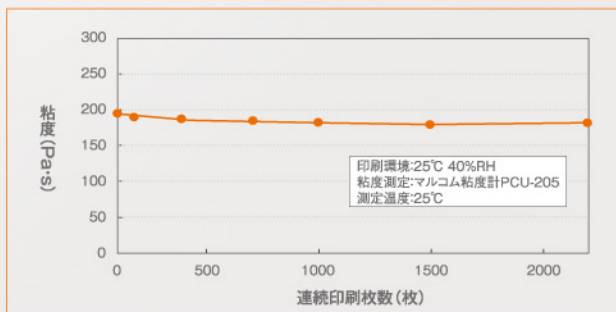
### 加熱だれ ブリッジやボールの原因となる加熱だれを抑制



【試験条件】 熱風循環型電気オーブンにて190°C 90秒間加熱

### 連続印刷性試験 2000枚以降も安定した印刷性を確保

#### ■ 連続印刷時の粘度変化



※上記データ、写真は特定条件下によるものです。